# USB2.0 HUB 控制器集成电路

USB 2.0 HIGH SPEED 4-PORT HUB CONTROLLER

**SL2.2s** 

数据手册

Data Sheet

# CoreChips ShenZhen CO.,Ltd

### 内容目录

第一章 管脚分配	3
1.1 SL2. 2s 管脚图	3
1.2 SL2.2s 管脚定义	3
第二章 功能叙述	5
2.1 综述	5
2.2 指示灯	5
2.2.1 单灯方案	5
2.2.2 多灯方案	
2.2.3 LED 指示定义	
2.3 过流保护	
2.4 充电支持	
2.5 I2C 接口	
2.6 EEPROM 设置	
第三章 电气特性	8
3.1 极限工作条件	8
3.2 工作范围	8
3.3 直流电特性	8
3.4 HS/FS/LS 电气特性	
3.5 ESD 特性	8
附录一 封装	9
表格目录	
表格 1: 端口 LED 定义	6
表格 2: ACTIVE LED 定义	6
表格 3: EEPROM 数据结构定义	7
表格 4: 最大额定值	8
表格 5: 工作范围	
表格 6: 直流电特性	
<b>《竹 0. 且加电时压</b>	0
插图目录	
图 1: SSOP28 管脚图	3
图 2: 单灯方案配置	
图 3: 5 灯方案配置	
凶 ン り 八 犬 和 且	0
图 4: 附录 封装图	^

## 第一章 管脚分配

### 1.1 SL2. 2s 管脚图

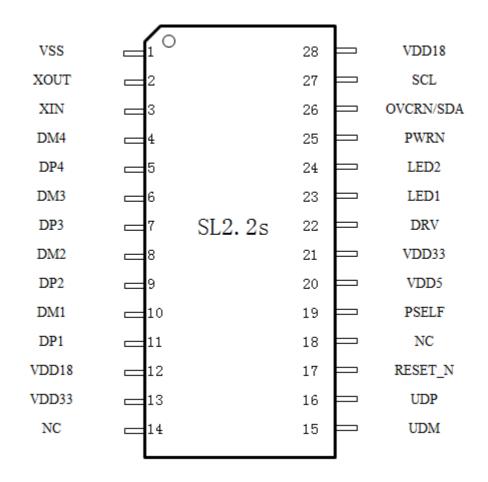


图 1: SSOP28 管脚图

### 1.2 SL2.2s 管脚定义

管脚名称	28 Pin#	Die	IO类型	定义						
VSS	1		P	芯片地						
XOUT	2		О	晶振PAD						
XIN	3		I	育力派と名力						
DM4	4		В	下行口 4 的USB信号						
DP4	5		В	[1] 口 4 的USB信号						

## CoreChips ShenZhen CO.,Ltd

DM3 6		В							
DP3	7	В	下行口 3 的USB信号						
DM2	8	В	TED A MUCDED						
DP2	9	В	下行口 2 的USB信号						
DM1	10	В	下行口 1 的USB信号						
DP1	11	В	1.41 中 1 印の90月 2						
VDD18	12	P	模拟 1.8v						
VDD33	13	P	模拟 3.3v						
-	14		NC						
UDM	15	В	上行口的USB信号						
UDP	16	В	上11 口印(USB)信 与						
RESET_N	17	I,Pu	芯片外部复位输入						
-	18		NC						
PSELF	19	I,Pu	高为自供电,低为总线供电						
VDD5	20	P	5v输入						
VDD33	21	P	3.3v输出						
DRV	22	B,Pu	点灯驱动信号						
LED1	23	B,Pu	点灯驱动信号						
LED2	24	B,Pu	点灯驱动信号						
PWRN	25	B,Pu	下行口电源输出控制,低有效						
OVCRN/SDA	26	B,Pu	I2C SDA数据线,内部上拉; 芯片初始化完成后作为过流保护输入脚,低有 效						
SCL	27	B,Pu	I2C SCL时钟输出						
VDD18	28	P	数字 1.8v						

**注释:** O, 输出; I 输入; B 双向; P 电源/接地; Pu 上拉; Pd 下拉; NC 悬空;

## 第二章 功能叙述

#### 2.1 综述

SL2.2s 是一颗高集成度,高性能,低功耗的 USB2.0 集线器主控芯片;该芯片 采用 STT 技术,单电源供电方式,芯片供电电压为 5v,内部集成 5V 转 3. 3V,只需在外部电源添加滤波电容;芯片自带复位电路,低功耗技术让他更加出众。

- 完美支持 USB2.0 高速(480MHz),USB2.0 全速(12MHz),和低速模式(1.5MHz)
- SL2.2s外部连接12M晶体振荡器。
- 集成 12MHz-to-480MHz PPL(Phase Lock Loop)
- 采用 Single Transaction Translator (STT)技术,是\*TT 系列中最具成本和效率方案
- 支持自供电到总线供电的自动枚举切换
- 支持使用外部 EEPROM 自定义 VID\PID 信息
- 支持 5 个指示灯及单个指示灯的选择

#### 2.2 指示灯

用户根据自己的产品需要,选择多种点灯方案。所有的灯由 LED1、LED2 和 DRV 三个 PAD 组合驱动。

#### 2.2.1 单灯方案

下图中,如果不需要点灯,直接把 DRV 悬空即可。

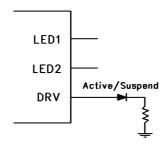


图 2: 单灯方案配置

#### 2.2.2 多灯方案

下图中, Active 灯可以根据用户需求去掉或者保留。

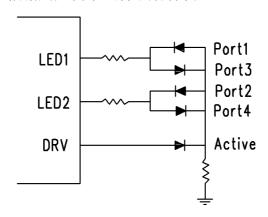


图 3:5 灯方案配置

#### 2.2.3 LED 指示定义

表格 1: 端口 LED 定义

端口LED状态	定义							
关闭	设备无接入或端口suspend							
长亮	设备正常工作							

表格 2: Active LED 定义

Active LED状态	定义
关闭	HUB Suspend
长亮	HUB正常工作

#### 2.3 过流保护

SL2.2s 过流保护支持 Ganged 模式。使用 OVCRN\_SDA 和 PWRN\_DOCKN 检测和控制下行口电源;

当 HUB 过流引脚检测到下行口电源过流信号下降沿并保持低电平 10 个 6MHz 时钟周期以上时,通过 PWRN\_DOCKN 关闭下行口设备供电并保持,上 报状态给主机,等待主机的后续命令。

#### 2.4 充电支持

SL2.2s 支持标准的 BC1.2 充电协议。

### 2.5 I2C 接口

SL2.2s 只支持 I2C Master 模式,可以自主从外部的 EEPROM 读取自定义数据。EEPROM 芯片地址为 0。

#### 2.6 EEPROM 设置

芯片可选外接 EEPROM 用于存放用户自定义的 PID/VID 等信息。EEPROM 内部定义见下表。

#### 表格 3: EEPROM 数据结构定义

#### 单位: Byte

	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	OD	0E	0F
00h	VID_L	VID_H	PID_L	PID_H	CHKSUM	A5										
10h																
20h	Vendor															
2011	string	string														
30h																
40h	Product															
1011	length	length														
50h						Proc	luct	string	g							
60h																
	Serial															
70h	number Serial number string															
	length															

#### 注:

- CHKSUM = VID\_H + VID\_L + PID\_H + PID\_L + 1。不满足等式的EEPROM内容将被忽略。
- Max power表示最大功耗,范围是0-500mA; 16进制为00H-FAH(单位是2mA)。
- String length>0时,字符串有效。字符串编码为UNICODE,LANGID: 0x0409(United States)。

# 第三章 电气特性

### 3.1 极限工作条件

表格 4: 最大额定值

符号	参数	最小值	最大值	単位		
$\mathbf{V}_{ ext{DDM}}$	Power Supply	-0.5	+5.5	V		
VIN	Input Voltage for digital I/O	-0.5	+5.5	V		
VINUSB	Input Voltage for USB signal (DP, DM) pins	-0.5	+3.6	V		
Ts	Storage Temperature under bias	-60 +100 °C				
Fosc	Frequency	12 MHz ± 0.05%				

### 3.2 工作范围

表格 5: 工作范围

符号	参数	最小值	典型	最大值	単位
$V_{DD}$	Power Supply	4.0	5.0	5.25	V
VIND	Input Voltage for digital I/O pins	-0.5	3.3	5.5	V
VINUSB	Input Voltage for USB signal (DP, DM) pins	0.5	3.3	5.25	V
TA	Ambient Temperature	0	-	70	$^{\circ}$

#### 3.3 直流电特性

表格 6: 直流电特性

符号	参数	最小值	典型	最大值	単位
$I_{DD}$	Supply Current	50	-	120	mA
$I_{SUS}$	Suspend Current	-	-	2.5	mA

### 3.4 HS/FS/LS 电气特性

参看 USB2.0 标准。

### 3.5 ESD 特性

本芯片端口 ESD 能力为±4KV(HBM)。

# 附录 封装

SL2.2S SSOP28 (Bodysize:10\*4mm Pitch:0.635)

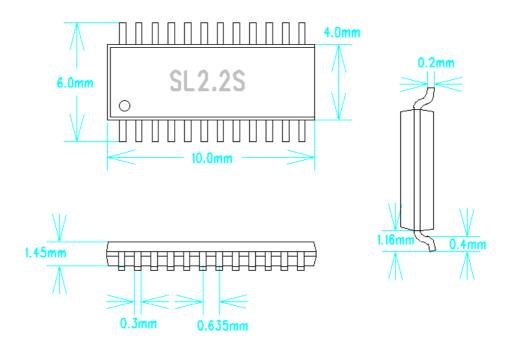


图 4: 封装尺寸图